



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 硬质公制连接器



PCB 连接器组件类型: **PCB 安装母端**

列数: 5

背板架构: **传统背板**

连接器系统: **板对板**

Number of Positions: 5

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

列数	5
背板架构	传统背板
Number of Positions	5
PCB 安装方向	直角

接触件特性

端子类型	插座
CompactPCI 名称	无
端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]



机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	3 mm[.118 in]
壳体颜色	土黄色

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

AdvancedTCA 指定产品	否
------------------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

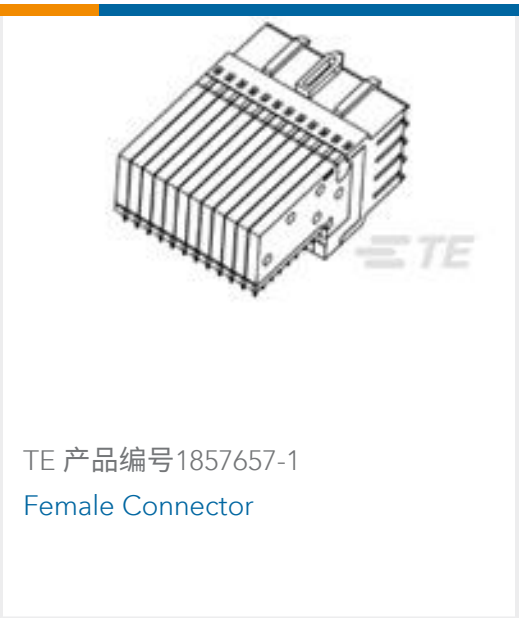
配套部件



该系列中的其他产品 | Z-PACK Slim UHD



客户还购买了



文档

产品图纸

Z-PACK Slim UHD Power 5 pos pl

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1982260-5_1.2d_dxf.zip



英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1982260-5_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1982260-5_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Z-Pack Slim UHD Connector Platform](#)

英文版本

[High Speed Backplane Connectors catalog - Z-PACK Slim UHD Connector](#)

英文版本

[POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC01_BOARD_TO_BOARD](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本